附表9-2

半导体所知识产权申请审批表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门/项目组 |  | 姓名 |  | 知识产权类型 |  |
| 课题名称（明确在何项目研究中产生的知识产权） |  | 课题编号（ARP） |  |
| 课题来源 |  | 课题密级 |  |
| 申请名称 |  |
| 发明人排序 |  |
| 发明内容简述 |  |
| 申请人承诺 | 本人申请知识产权的内容不涉及国家秘密，申请中的文字、图、表、数值等均不牵扯他人的知识产权，由此产生的涉密等问题，我愿承担一切法律责任。申请人签字： 年 月 日 |
| 课题负责人审查意见 | □同意 □不同意（原因） 负责人签字： 年 月 日 |
| 部门负责人审查意见 | □同意 □不同意（原因） 负责人签字： 年 月 日 |
| 成果与信息化中心审批意见 | □同意 □不同意（原因） 主管签字： 年 月 日 |

注：相关涉密信息做脱密处理。

注：知识产权类型指发明，实用新型，集成布图，软件著作权等。

注：课题密级为非密，内部，秘密，机密。